

자 기 소 개 서 (샘플)

신청자	학과	-----	학번(학년)	----
	성명	-----	성별	-----
	e-mail	-----	졸업예정시기	-----
	연락처(H.P)	-----	부전공여부	-----
	연구실소속여부(교수님성함)			
	지원 경로	<input type="checkbox"/> 검색 <input checked="" type="checkbox"/> 지인추천 <input checked="" type="checkbox"/> 현수막 및 홍보물 확인 <input type="checkbox"/> 기타 _____ (해당란에 <input checked="" type="checkbox"/> 표시)		
신청 목적	올해 1학기에 수강한 물리전자에서 열심히 공부하여 좋은 성적을 얻게 되었고, 반도체에 대한 흥미를 느끼고 더 알아보던 중, 반도체 융합전공을 알게되어 핵심인재로 거듭날 수 있는 좋은 기회라 생각이 들어 지원하게 되었습니다.			
동일유사 교과목 (붙임1과 성적표 참고)	연번	동일유사과목코드	동일유사교과목	구분
	1	ECE2014	논리회로설계	전필
	2	MSE2013	전자기학	전필
	3	EEE2001	회로이론1	전필
	4	ECE3075	물리전자	전선
	5	ECE3040	집적회로설계	전선
	6	ECE3008	전자회로1	전필
이수 계획	2024년도 2학기		2025년도 1학기	
	반도체공학		RF회로설계	
	초고주파공학		인공지능	
	인공지능반도체설계		반도체공정공학	
역량개발 및 희망진로	저는 해당 프로그램을 통해 인공지능 시대에 걸맞은 반도체인 인공지능 반도체나 시스템 반도체를 개발하거나 공정에 참여하고 싶습니다.			
본인은 반도체특성화대학사업단의 반도체 융합전공 제3기 학생 신청서를 제출합니다. 2024 년 07 월 01 일 신 청 자 : 전남대학교 반도체특성화대학사업단장 귀하				